

無鉛/無鹵錫膏



本公司生產的無鉛無鹵錫膏系採用特殊的助焊劑與氧化物含量極少的球形共晶合金粉製造而成。具卓越的連續印刷性；此外，產品所含的助焊劑，採用具有高信賴之活化劑系統，使其在迴焊之後的殘留，即使免洗也能擁有極高的可靠性。

一、合金規格

合金名稱 產品型號	Sn	Ag	Pb	Cu	Sb	Zn	Fe	As	Bi	Cd	Al	Ni	Ge
SM988	REM.	3±0.15	<0.1	0.5±0.2	<0.2	<0.003	<0.02	<0.03	<0.10	<0.002	<0.005	<0.08	<0.015
SM988-1	REM.	0.3±0.01	<0.1	0.7±0.1	<0.2	<0.003	<0.02	<0.03	<0.10	<0.002	<0.005	0.03	0.01
SM528													
SM588	REM.	1.0±0.15	<0.1	<0.03	<0.2	<0.003	<0.02	<0.03	35±0.5	<0.002	<0.005	0.03	0.01
HF106													
HF107	REM.	<0.03	<0.1	<0.03	<0.2	<0.003	<0.02	<0.03	42±0.5	<0.002	<0.005	0.03	0.01
HF108													

其他合金可依據客戶要求訂製，請聯繫業務代表。

特點

- 1.) 產品為免洗型，迴焊後殘留物極少，可滿足ICT探針測試性能。
- 2.) 連續印刷時，其黏度極少經時間變化，可獲得非常穩定印刷性。
- 3.) 擁有極佳焊接性，可在不同部位表現出適當的沾濕性。
- 4.) 可適用於一般大氣下與氮氣之迴焊爐。
- 5.) 迴焊後產生的錫球極少，焊點光澤良好，導電性能優異。
- 6.) 助焊劑載體無刺激性氣味，揮發慢，可長時間印刷不會影響到錫膏的印刷效果。
- 7.) 黏度適中，優異的脫膜性，印刷中和印刷後不易坍塌，可減少短路的發生。
- 8.) 對0.4 mm及以上間距的電路板，可完成精美的印刷。

針筒錫膏

針筒錫膏由特殊助焊劑與低氧化度的球形焊料粉末組成，採用高性能觸變劑，具有優越的溶解性和持續性以及優異的脫膜性。點塗中和點塗後不易坍塌，可減少短路的發生。長時間點塗不容易堵塞針頭。